

2024年4月24日

各位

会社名 株式会社倉元製作所  
代表者名 代表取締役社長 渡邊敏行  
(コード番号 5216 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 小峰 衛  
電話番号 0228-32-5111

## 新たな事業の開始及び Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd.

### (杭州美迪凱光電科技股份有限公司) との製造委託基本契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新たに次世代半導体パッケージ向けの TGV(Through Glass Via : ガラス貫通電極)・TSV (Through silicon via : シリコン貫通電極)・SiC (Silicon carbide : 炭化ケイ素) 関連製品の製造委託基本契約を、Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd (杭州美迪凱光電科技股份有限公司。以下「MDK 社」という) と締結し、上記 TGV・TSV・SiC 関連製品の製造、販売を開始することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 1. 新たな事業の概要

##### (1) 当該事業の内容

本契約により、当社は、日本及びアジア地域における営業ネットワークを活用して、上記 TGV・TSV・SiC 関連製品の新規顧客を開拓し、顧客仕様に基づき、MDK 社が製造(加工)して当社を通じて顧客に販売します。

◆TGV(Through Glass Via : ガラス貫通電極)で採用されるガラス基板は、従来の有機基板と比較して 10 倍の高集積化と高性能が見込めるパッケージング技術です。TGV ガラス基板の技術的レベルは、2024 年現在、TGV 基板の日本での最先端技術は Via (穴径) 10  $\mu\text{m}$ 、アスペクト比 (板厚/穴系) 10 倍程度\*1 ですが、MDK 社の技術は、Via (穴径) 10  $\mu\text{m}$ 、アスペクト比 (板厚/穴系) 20 倍を達成しており、さらに Via (穴径) 5  $\mu\text{m}$ 、アスペクト比 (板厚/穴系) 40 倍も開発中です。

TGV ガラス基板の用途は、インテル社の発表\*2 によると、生成系 AI や GPU (Graphics Processing Unit-画像処理装置)、HPC (high-performance computing – 高性能計算) など、特に高いパフォーマンスが求められる大型フォームファクタ (マザーボードやモバイルデバイスの基板など) のチップに搭載されることが想定されています。

\*1 当社調べ

\*2 インテル社の TGV 採用プレス発表より。[Http://tinyurl.com/28nozbbh](http://tinyurl.com/28nozbbh)

◆ TSV (Through silicon via : シリコン貫通電極)は、従来のワイヤーによる半導体チップ間接続に代わり、シリコンウェーハ内部に上下貫通電極により接続する技術で、高速化/小型化/高密度化/低消費電力化が同時に達成できます。

◆ SiC (Silicon carbide : 炭化ケイ素) は、高耐熱性、耐摩耗性、耐食性を持ち、電気伝導性も優れており、EV (電気自動車) など様々なパワーエレクトロニクス分野で使用されています。

当社は、上記 TGV・TSV・SiC 関連製品のプロセスメーカーに対して、顧客仕様の製品モジュールを当社ブランドにて MDK 社から製品供給を受けて提供いたします。また、TGV 関連製品について、当社のガラス基板切面加工技術、スパッタ成膜、基板両面研磨技術を活用した当社製品の既存供給先に、MDK 社から製品供給を提案し、複合して販売することも計画しています。

(2) 当該事業を担当する部門  
基板事業部

(3) 当該事業の開始のために特別に支出する金額及び内容  
現時点で該当事項はありません。

## 2. 相手先の概要

(1) 名称	Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd. (杭州美迪凱光電科技股份有限公司)	
(2) 所在地	578# NO.20 Street.Hangzhou Econo&Tech. Development Zone, Hangzhou.310018,CHINA	
(3) 代表者の役職・氏名	Wenzhi Ge Chairman of the Board & GM	
(4) 事業内容	半導体コンポーネントと精密処理ソリューション、生体認証コンポーネントと精密処理ソリューション、イメージング光学コンポーネント、拡張現実 (AR)・混合現実 (MR) 光学コンポーネント精密処理ソリューション事業	
(5) 資本金	401 百万円 CNY	
(6) 設立年月日	2010 年 8 月 25 日	
(7) 主要取引先	京セラ株式会社, パナソニック株式会社, 株式会社ニコン, ソニー株式会社, キヤノン株式会社	
(8) 上場証券取引所	上海証券取引所 証券コード: 688079 <a href="http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=688079">http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=688079</a> 時価総額 1060 億円 (JPY) (2023.12.31 現在)	
(9) 当社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者取引	該当事項はありません。

## 3. 日程

取締役会決議日 2024 年 4 月 24 日

事業開始日 2024 年 4 月 25 日

## 4. 今後の見通し

本件が 2024 年 12 月期の当社業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に重要な影響を与える見込みが生じた場合には、速やかにお知らせします。

以上